

발광장치 및 이를 구비하는 조명장치

(LIGHT EMITTING DEVICE AND LIGHTING DEVICE HAVING THE SAME)

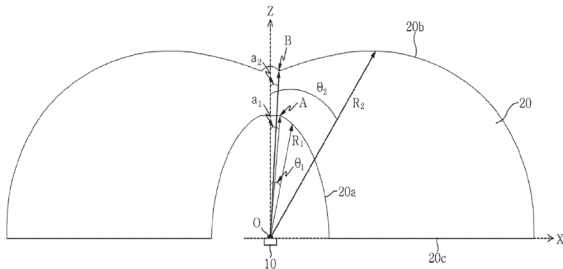
출원번호(일자): 1020120085062 (2012.08.03)

등록번호(일자): 1013558150000 (2014.01.21)

출원인: 방주광학 주식회사

| 요약 |

본 발명의 실시예에 따른 발광장치는 광원과 광학렌즈를 포함하되, 광학렌즈는 광원으로부터 출사된 광이 광학렌즈에 입사되는 광입사면과 광입사면에 입사한 광이 광학렌즈로부터 출사되는 광출사면을 구비하고, 광입사면은 기준광축에 대해 축 대칭인 평평한 면과 볼록한 곡면을 포함하고, 광출사면은 기준광축에 대해 축 대칭인 두 부분의 볼록한 곡면을 포함한다.



운송 장치에 적용되는 터치스크린용 투명전극 구조체

(Transparent electrode structure for touch screen applying for a vehicle)

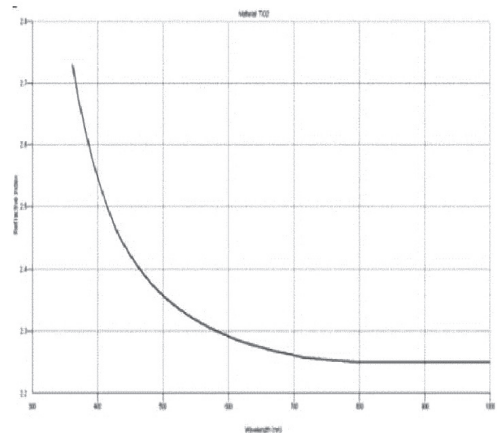
출원번호(일자): 1020130047731 (2013.04.29)

등록번호(일자): 1013859520000 (2014.04.10)

출원인: 주식회사 옵트론텍

| 요약 |

본 발명은, 기판 상에 타겟으로 각각 60 내지 80Å 두께의 Y2O3, 45 내지 65Å 두께의 TiO2, 553 내지 573Å 두께의 SiO2, 127 내지 147Å 두께의 TiO2, 279 내지 299Å 두께의 SiO2, 및 240 내지 260Å 두께의 ITO를 전자빔 증착법으로 각각 순차적으로 적층하여 얻어진 것을 특징으로 하는 운송 장치에 적용되는 터치스크린용 투명전극 구조체로서, 상기 운송 장치에 적용되는 터치스크린용 투명전극 구조체는 패널제작의 기본 부재인 유리 또는 고분자 필름의 자체적인 투과율과 가장 근접하게 투명전극의 투과율을 형성시켜, 투명전극의 패턴 형성 후 육안으로 식별이 되지 않도록 투명성을 개선하고, 또한 단파장대역(450nm)의 산화인듐주석(ITO)의 흡광계수를 제어함으로써 ITO의 황변현상을 억제하여 광원과의 조립 후 디스플레이 광원자체의 투과율 저하나 색상편차 문제를 개선하며, Y2O3를 구조체의 적층 재료로 구성함으로써 내화성 및 내화학성이 우수하여 외부 환경변화에 대응에 유리하다. 즉 본 발명에 따른 운송 장치에 적용되는 터치스크린용 투명전극 구조체는 최종 패널제품의 시인성, 내화성, 내화학성을 향상시킬 수 있다.



전자빔 증착법을 이용한 터치스크린용 투명 전극 구조체 및 이를 포함한 터치스크린 패널

(Transparent electrode structure for touch screen using electron beam evaporation and touch screen panel comprising the same)

출원번호(일자): 1020130047730 (2013.04.29)
 등록번호(일자): 1013859510000 (2014.04.10)
 출원인: 주식회사 옵트론텍

| 요약 |

본 발명은 본 발명은 전자빔 증착법을 이용한 터치스크린용 투명전극 구조체 및 이를 포함한 터치스크린 패널에 관한 것으로, 보다 상세하게는 기판 상에 타겟으로 각각 35 내지 55Å 두께의 TiO₂, 450 내지 475Å 두께의 SiO₂, 125 내지 145Å 두께의 TiO₂, 275 내지 300Å 두께의 SiO₂ 및 240 내지 260Å 두께의 ITO를 전자빔 증착법으로 각각 순차적으로 적층하여 얻어진 것을 특징으로 하는 터치스크린용 투명전극 구조체로서, 상기 투명전극 구조체는 패널제작의 기본 부재인 유리 또는 고분자 필름의 자체적인 투과율과 가장 근접하게 투명전극의 투과율을 형성시켜, 투명전극의 패턴 형성후 육안으로 식별이 되지 않도록 투명성을 개선하고, 또한 단파장대역(450nm)의 산화인듐주석(ITO)의 흡광계수를 제어함으로써 ITO의 황변현상을 억제하여 광원과의 조립후 디스플레이 광원자체의 투과율 저하나 색상편차 문제를 개선하며 투명성을 최대한 유지한 투명전극을 제작할 수 있기 때문에 투명전극의 투명성 향상을 통해서 최종 패널제품의 시인성을 향상시킬 수 있다.

ITO	250Å
SiO ₂	289Å
TiO ₂	137Å
SiO ₂	463Å
TiO ₂	45Å
투명 부재	Glass

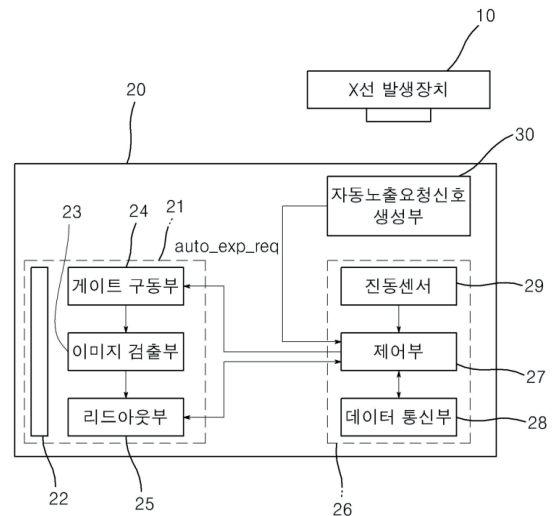
X선 영상 촬영 장치 및 그 방법

(APPARATUS FOR DETECTING X-RAY AND METHOD THEREOF)

출원번호(일자): 1020120119477 (2012.10.26)
 등록번호(일자): 1013771150000 (2014.03.17)
 공개번호(일자): 1020140034018 (2014.03.19)
 출원인: 주식회사 뷰웍스

| 요약 |

X선 영상 촬영 장치 및 그 방법이 제공된다. 본 발명은 X선 발생 장치로부터 조사되는 X선을 검출하여 자체적으로 생성한 자동노출요청신호를 이용하여 X선 영상을 촬영함에 있어서, 자동노출요청신호의 유효성을 검증함으로써 진동이나 온도 변화 또는 잡음 등에 의해 의도하지 않은 자동노출요청신호가 생성되는 것을 방지할 수 있어 X선 촬영 동작 및 촬영된 X선 영상의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.

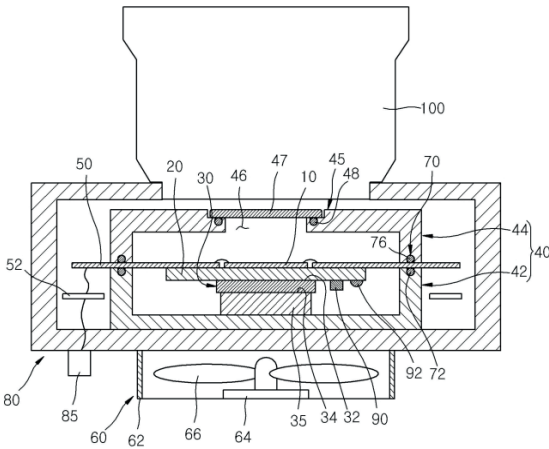


방열형 라인스캔카메라
RADIATE HEAT TYPE LINE SCAN CAMERA

출원번호(일자): 1020120079857 (2012.07.23)
 등록번호(일자): 1013836940000 (2014.04.03)
 공개번호(일자): 1020140013271 (2014.02.05)
 출원인: 주식회사 뷰웍스

| 요약 |

방열형 라인스캔카메라에 대한 발명이 개시된다. 개시된 방열형 라인스캔카메라는: 피사체의 영상을 획득하는 라인센서와, 라인센서에 연결되어 피사체의 영상을 전달받으며 라인센서의 측면 방향으로 연장되는 메인제어부와, 라인센서와 메인제어부에 접하여 설치되며 라인센서에서 발생된 열을 외측으로 방열시키는 방열부재와, 방열부재에 접하여 냉각이 이루어지는 냉각면과 냉각면에 반대되는 방향으로 설치되어 발열이 이루어지는 발열면을 구비하는 전열쿨러와, 발열면에 접하여 설치되며 열 전달이 이루어지는 연결블록과, 연결블록과 메인제어부의 하부에 접하여 설치되는 하부하우징과, 하부하우징의 상측에 설치되며 메인제어부의 상부에 접하여 설치되는 상부하우징 및 메인제어부와 하부하우징의 사이와 메인제어부와 상부하우징의 사이에 설치되어 습기의 이동을 방지하는 기밀부를 구비하는 것을 특징으로 한다.

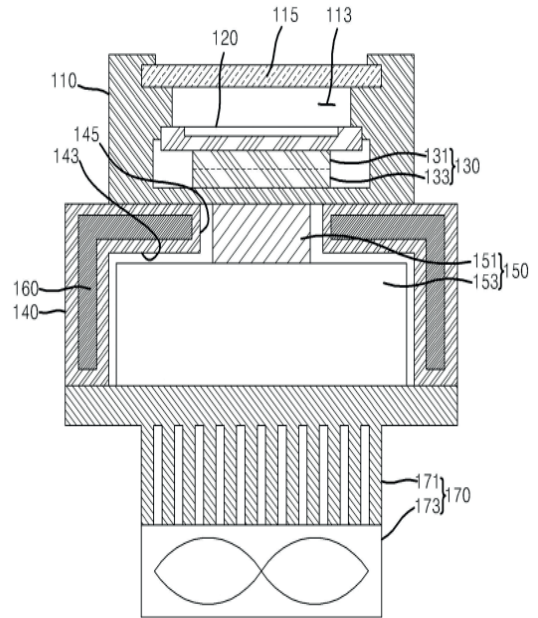


영상촬영장치
(IMAGE PHOTOGRAPHY APPARATUS)

출원번호(일자): 1020130047326 (2013.04.29)
 등록번호(일자): 1013911760000 (2014.04.25)
 출원인: 주식회사 뷰웍스

| 요약 |

영상촬영장치에 대한 발명이 개시된다. 본 발명의 영상 촬영장치는: 이미지 센서; 이미지 센서의 일측에 배치되어 이미지 센서를 냉각시키는 냉각장치; 및 냉각장치의 일측에 배치되어 이미지 센서와 냉각장치를 이동시키는 이동장치를 포함하는 것을 특징으로 한다.



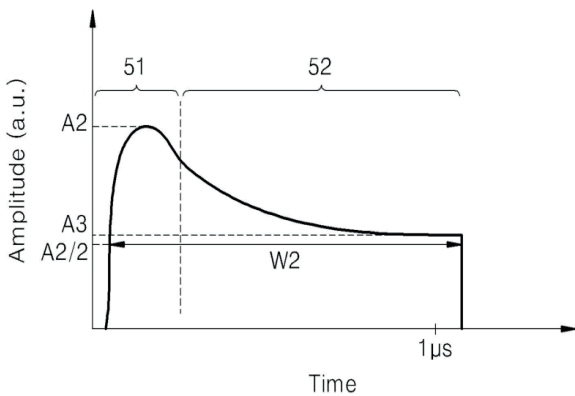
레이저 가공방법

(Laser processing method)

출원번호(일자): 1020120034249 (2012.04.03)
 등록번호(일자): 1013617770000 (2014.02.05)
 공개번호(일자): 1020130112110 (2013.10.14)
 출원인: 주식회사 이오테크닉스

| 요약 |

레이저 가공방법이 개시된다. 개시된 레이저 가공방법은 레이저광을 가공 대상물의 내부에 포커싱하여 이동시킴으로써 상기 가공 대상물 내부에 다광자 흡수에 의한 적어도 하나의 개질영역을 형성하며, 상기 레이저광은 $1 \mu\text{s}$ 보다 큰 펄스폭을 가진다.



레이저 절단 장치 및 레이저 절단 방법

(Laser cutting apparatus and laser cutting method)

출원번호(일자): 1020110112881 (2011.11.01)
 등록번호(일자): 1013794110000 (2014.03.24)
 공개번호(일자): 1020130048006 (2013.05.09)
 출원인: 주식회사 이오테크닉스

| 요약 |

하이브리드 레이저를 이용한 레이저 절단 장치 및 레이저 절단 방법이 개시된다. 개시된 레이저 절단 장치는, 기판의 절단 예정부를 가열하기 위한 열빔을 출사시키는 제1 레이저 발진기; 상기 열빔에 의해 가열된 기판의 절단 예정부를 절단시키기 위한 가공빔을 출사시키는 제2 레이저 발진기; 및 열빔과 상기 제2 레이저 발진기로부터 출사되는 가공빔을 기판의 절단 예정부에 조사하는 스캔 미러를 구비한다. 여기서, 상기 열빔은 기판의 이동방향을 따라 가공빔보다 선행하여 기판의 절단 예정부에 조사된다.

